

# 會議論文徵稿通知 – ISPD 2023

ACM 國際實體設計技術研討會

致敬 Malgorzata Marek-Sadowska 教授

2023 年 3 月 26 至 29 日 虛擬會議 <http://www.ispd.cc/>

ACM SIGDA / IEEE CEDA 聯合贊助

國際實體設計技術研討會提供與會者一個頂尖論壇，以交流意見並促進創新研究，主題涵蓋 ASIC 和 FPGA 傳統實體設計技術以及新興技術於本領域之效應與挑戰。ISPD 2023 將採虛擬會議模式舉辦，為與會者提供即時視頻和預錄會議，第 32 屆會議將突顯嶄新重點方向與前瞻理論與實驗貢獻，歡迎各界踴躍投稿。

**徵稿實體設計主題包括但不限於：**

佈局規劃和連線規劃

分割、擺置和繞線

時脈與電源網絡

布局後與矽後優化

製造可行性和良率的實體設計與優化

實體合成

與系統和邏輯階層設計的交互作用

時序和功耗估算、建模與優化

實體設計環境中的電路分析與優化

數據管理、多執行緒/分散式演算法

熱門主題如機器學習與硬體安全

3D 堆疊、量子電路與其他新興技術的實體設計

**重要時程**

標題和摘要繳交截止日期

2022 年 9 月 30 日

完整的稿件繳交截止日期

2022 年 10 月 7 日

論文接受通知

2022 年 11 月 11 日

論文完稿與講者註冊期限

2023 年 1 月 30 日

會期

2023 年 3 月 26 至 29 日

**投稿方式**

所有論文必須透過網站 <https://easychair.org/conferences/?conf=ispd2023> 進行電子投稿。詳情將在網站 <http://www.ispd.cc> 上公告。作者將被要求上傳完整原創論文，至多 8 頁之 PDF 檔案並採用 ACM 會議格式 <https://www.acm.org/publications/proceedings-template>。違反上開頁數格式及下列要求將導致論文被拒絕。

已發表的論文或同時投稿至其他會議/期刊的論文將不予考慮。若相關論文先前已經發表或同時投稿至他處，作者應明確說明這些論文與當前投稿的論文之間的差異。所有投稿的論文都將進行盲審，因此不得在稿件的任何地方揭露作者姓名或所屬機構。並應以第三人方式論述作者先前的論文。鼓勵提供開源軟體之研究成果，但請勿提供非匿名軟體之連結，請於論文中指出開源貢獻。

會議論文集將收錄於 ACM Digital Library。ISPD 設有最佳論文獎表彰優秀的貢獻，於投稿論文中遴選。將頒發獎金一千美金與獎牌予最佳論文獎論文，另設獎金予最佳論文候選論文。

每篇接受論文的演講者必須註冊、提供簡報檔與錄製簡報視頻並參加線上會議討論。簡報將於大會網頁公開，簡報與視頻版權歸作者所有，簡報視頻將收錄於 ISPD 2023 Youtube 頻道。

被收受論文之所有合著者受 [ACM 出版物政策](#) 的約束，包括 [涉及人類參與者和受試者的研究](#)。違規行為將由 ACM 進行調查，並可能導致論文完全撤回，以及其他潛在的處罰。ACM 於 2022 年起要求被接受論文之作者必須獲得 [ORCID ID](#) 才能發表，請參閱 [常見問題](#) 以了解更多詳細訊息。此項要求是為了提高作者的能見度，確保正確歸屬並協助姓名規範化。

**大會組織**

大會主席

David Chinnery (Siemens Digital Industries Software)

指導委員會主席

Stephen Yang (Leda Technology)

議程主席

Iris Hui-Ru Jiang (National Taiwan University)

出版主席

Gracieli Posser (Cadence Design Systems)

公關主席

Stephan Held (University of Bonn)

財務主席

Patrick Madden (State University of New York at Binghamton)

一般委員

Joseph Shinnerl (Siemens Digital Industries Software)